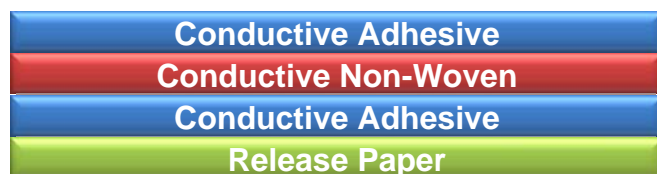




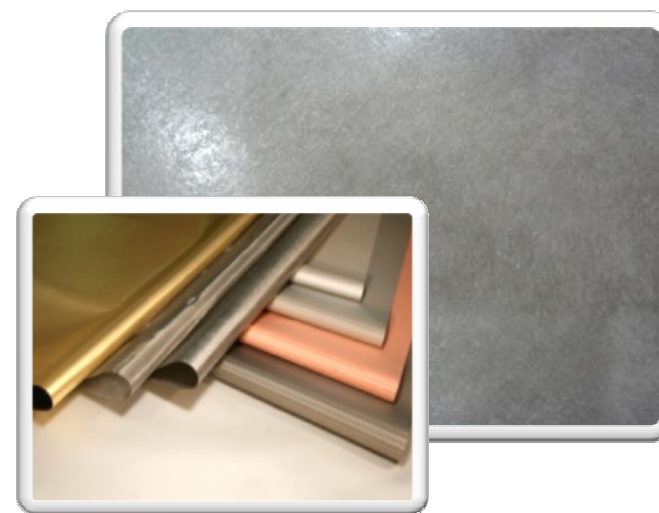
導電膠帶(Conductive Tape)

導電膠布(Conductive Adhesive Tape)-SELID-NW系列

SELID-NW膠帶的設計應用為 需要二點(面)間的導電接點(面)可確實的接觸在一起, 特別是EMI遮蔽, 接地及靜電防護. 全厚度為30um厚, 可用於大部份的顯示裝置設計



總厚度 30um



項目	數值(Value)	註記
黏著力 (180°peel)	1200 (gf/25mm) Min. 500	PET Film (25um) / SUS 304 Plate
保持力(Holding Power)	< 0.5mm	25mmx25mm 60°C, 1Kg
接觸阻抗	< 0.05	Ω /25mm ² / 1Kg壓力

應用例

- 電子元件
- 電路板/纜線
- 行動手機
- 平板電腦
- 筆記型電腦



導電膠帶(Conductive Tape)

導電膠布(Conductive Adhesive Tape)-SELID-NW系列

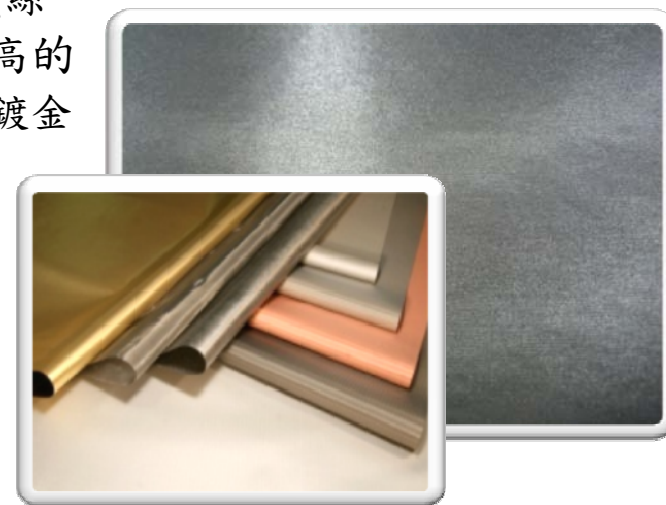
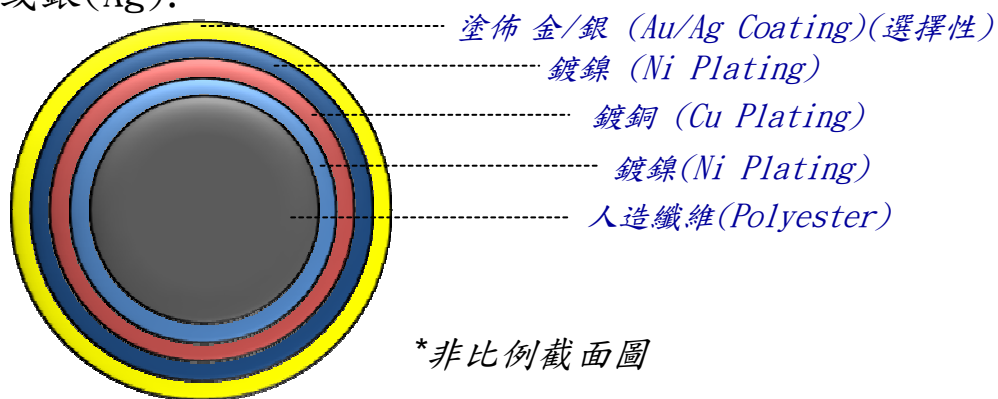
單面背膠			
型號(P/N)	厚度 (mm)	黏著力 (gf/25mm)	接觸阻抗 (Ω/in^2)
SELID-NW01-0.03T	0.03	Min. 500	Max. 0.05
SELID-NW01-0.06T	0.06	Min. 1000	Max. 0.05
SELID-NW01-0.09T	0.09	Min. 1000	Max. 0.1
SELID-NW01-0.18T	0.18	Min. 1000	Max. 0.1
雙面背膠			
型號(P/N)	厚度 (mm)	黏著力 (gf/25mm)	接觸阻抗 (Ω/in^2)
SELID-NW11-0.03T	0.03	Min. 500	Max. 0.05
SELID-NW11-0.05T	0.05	Min. 1000	Max. 0.05
SELID-NW11-0.10T	0.10	Min. 1000	Max. 0.1
SELID-NW11-0.20T	0.20	Min. 1000	Max. 0.1



導電膠帶(Conductive Tape)

導電膠布(Conductive Adhesive Tape)-SELID-NT/NFR系列

生產製造時是在於聚酯樹脂纖維Polyester(PES)(人造纖維)纖維上鍍上鎳(Ni)及銅(Cu). 而基本纖維絲的鎳層外是鍍上導電性高的銅, 另可在銅層上電鍍或不鍍一層抗腐蝕的鎳及最外層可選擇鍍金(Au)或銀(Ag).



項目	數值(Value)	註記
厚度	0.03~0.18	mm
接觸阻抗	$\leq 0.03 \sim \leq 0.2$	$\Omega/25\text{mm}^2$ / 1Kg 壓力 MIL-G-8835285
電磁波遮蔽率	Min. 60 dB	ASTM D-4935

應用例

- 電子元件
- 電路板/纜線
- 行動手機
- 平板電腦
- 筆記型電腦

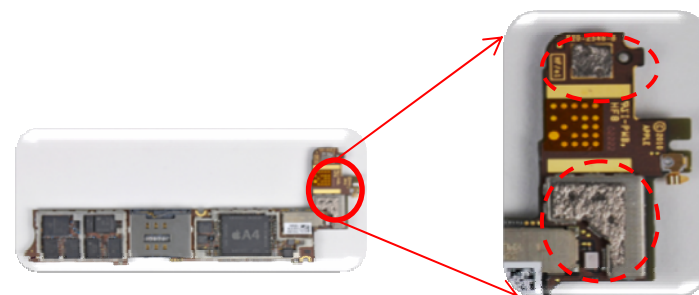


導電軟墊膠帶(Conductive Cushion Tape)

(伊特龍E-Foam)PE發泡材 SELID-NOF & SELID-SOF 系列

參考(設計導入)

1. 大型顯示器
 - 三星液晶電視
 - 三星銀河平板I(Galaxy Tab I)
2. 小型顯示器
 - 三星(Samsung) 行動手機
 - 樂金(LG) OLED顯示模組(PBA grounding)



智慧手機主版

